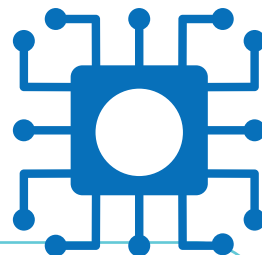


國科會第 33 次園區審議會核准 4 件投資案

The 33rd Science Park Investment Review Committee Approved 4 New Investment Projects
国家科学及び技術委員会第 33 回投資審議会が投資 4 件を許可しました

● 文／投資組 吳珣珊

國家科學及技術委員會科學園區審議會第 33 次會議於 2026 年 6 月 25 日通過衡信分析科技股份有限公司、漢泰先進材料股份有限公司銅科分公司、合聖科技股份有限公司竹南分公司、台灣迪恩士半導體科技股份有限公司竹科分公司等 4 案，共計核准投資新臺幣（以下同）12.5 億元。



衡信分析科技股份有限公司（設立於新竹園區）

本案投資金額 6 億元，主要產品為先進樣品製備分析服務（ASPA）、電性故障分析服務（EFA）及物性故障分析服務（PFA）等半導體故障分析相關技術服務。

本案公司為衡陞科技股份有限公司為落實集團專業分工所設立之子公司，規劃建置 2 奈米及以下先進製程之電性量測分析平台，專責高階故障分析服務。本案公司為業界首家從先進製程晶片電性故障分析為核心出發，結合奈米探針技術與高階分析設備，能精準鎖定複雜晶片的故障位置並提高故障分析的成功率，為半導體客戶提供高解析度與高靈敏度之量測解決方案，協助客戶提升於研發導入、製程優化與量產驗證等不同階段的分析效率與決策品質。

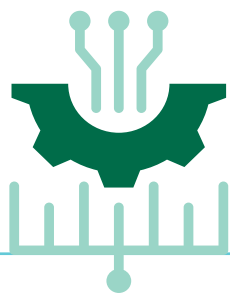
本案公司進駐將有助於提升園區高階半導體分析與檢測服務量能，強化先進製程技術自主性，增強我國半導體產業整體競爭力。

漢泰先進材料股份有限公司銅科分公司（設立於銅鑼園區）

本案投資金額 3.5 億元，主要開發半導體級 ESD 功能材料與表面工程整合平台。

本案公司專注於發展高附加價值功能性表面工程技術，以 ESD 防靜電功能性鍍膜為基礎，建構跨製程之功能性鍍膜技術平台，透過整合 ESD 防靜電鍍膜、耐磨鍍膜及高均勻性薄膜等技術，協助客戶在不改變既有基礎製程條件下，有效提升設備零組件於實際製程環境中的靜電防護能力、耐磨耗表現及整體可靠度，為半導體產業中所需關鍵技術。本案並將傳統單一表面處理加工模式，升級為技術導向的製程優化解決方案，提升整體技術層級與產業價值。

本案進駐園區有助於提升國內自主表面工程技術，降低國內高階設備關鍵零組件對國外鍍膜與材料服務的依賴性，提升我國半導體設備與材料產業之國際競爭力。



合聖科技股份有限公司竹南分公司（設立於竹南園區）

本案投資金額為 2 億元，核心產品涵蓋外部雷射光源模組（ELS）、具超穎透鏡之光纖陣列模組（FAU）及矽光子相關產品與應用技術服務。

本公司掌握矽光子共封裝技術（Co-Packaged Optics, CPO）之關鍵光學零組件技術，這項優勢使其能夠直接對接國際一線客戶的嚴格需求，針對 AI 資料中心及 CPO 等前瞻應用，提供具備高整合度的解決方案。

本公司透過設立竹南分公司不僅能大幅提升公司整體的營運績效，更展現了深耕臺灣矽光子產業鏈的強烈決心，預期將帶動國內光電與半導體封裝領域的技術發展與高階人才培育，確保臺灣在競爭激烈的全球 AI 市場中持續保持領先優勢。

台灣迪恩士半導體科技股份有限公司竹科分公司（設立於新竹園區）

本案投資金額為 1 億元，主要產品為從事晶圓洗淨設備之研發及技術服務。

本公司產品項目涵蓋單片式、批次式及旋刷式晶圓洗淨設備，可對應 16 奈米以下至 2 奈米及 1.4 奈米以下等先進半導體製程需求。核心技術包含先進乾燥技術、精準物理洗淨技術及高可靠度模組化設備設計，有助提升製程良率、降低設備停機風險，並強化整體生產效率。

台灣迪恩士半導體科技股份有限公司為日商 SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd. 於臺灣全資子公司，長期深耕半導體先進製程設備領域。本次設立竹科分公司，除承接日本母公司之關鍵專利與技術授權外，亦將推動在地研發能量、客製化設備改造及即時技術服務，深化與國內半導體產業之合作。

未來本公司將結合 ESG 節能與水資源再利用技術，協助半導體產業朝向高效率與永續發展，促進新竹科學園區高階半導體設備產業聚落之成長。

